



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100730002
2010 年 8 月 20 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA/PWR 18 ピンPDIPパッケージ 一部製品 組立サイト追加予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての一次予定の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)		☐ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	HPA/PWR 18 ピン PDIP パッケージ 一部製品 組立サイト追加 現行 : UTAC2 社(タイ) 変更後 : UTAC2 社(タイ), MMT 社(タイ)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	11 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント) 18ピンPDIPパッケージ 一部製品の組立サイトについて、現行 UTAC2社(タイ)サイトにて製造しておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、MMT社(タイ)サイトを追加する予定です。また、部材の変更は下記のような予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立サイト	UTAC2社(タイ)	UTAC2社(タイ) MMT社(タイ)

	現行	追加認定
組立サイト	UTAC2	MMT
チップ接着剤	Hit EN4088Z	Ablestik 84-1LMSR4
モールド樹脂	Nitto GE1030MDP	EME-G600V
リードフレーム (端子処理, 部材)	NiPdAu, Cu	NiPdAuAg, Cu

理由 : 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
ADS1210P	UC2526NG4	UC2874N-1	UC3526NG4	UC3874N-1
ADS1210PG4	UC2544N	UC2874N-1G4	UC3544N	UC3874N-1G4
ADS1212P	UC2544NG4	UC2874N-2	UC3544NG4	UC3874N-2
ADS1212PG4	UC2637N	UC2874N-2G4	UC3637N	UC3874N-2G4
DAC7541AJP	UC2637NG4	UC2903N	UC3637NG4	UC3903N
DAC7541AJP4	UC2841N	UC2903NG4	UC3841N	UC3903NG4
DAC7541AKP	UC2841NG4	UC2914N	UC3841NG4	UC3914N
DAC7541AKPG4	UC2851N	UC2914NG4	UC3851N	UC3914NG4
UC2526AN	UC2851NG4	UC3526AN	UC3851NG4	
UC2526ANG4	UC2871N	UC3526ANG4	UC3871N	
UC2526N	UC2871NG4	UC3526N	UC3871NG4	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L, 23L)が下記のようになる予定です。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)	組立国コード(23L)
現行	UTAC2	ASO: NS2	ACO: THA
追加認定	MMT	ASO: ALP	ACO: THA



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験計画

正形検査

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2010 年 4 月	終了	2010 年 9 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1210P	Die Sizes (mm):	3.63 X 6.3	
Assembly Site:	ALP - MMT	Package/Code/Pins:	PDIP/N/18	
Mount Compound:	Ablestik 84-1LMISR4	Mold Compound:	MP8000CH	
Bond Wire:	1.3 MIL Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	30	30	30
High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Visual / Mechanical	-	328	328	328
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units	22	-	-
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units	22	-	-
Lead Finish Adhesion	# of leads, min. 3 units	15	-	-
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Die Shear	-	10	10	10
Manufacturability, Assembly	Per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	Top side only	5	5	5

信頼性試験計画

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2010 年 4 月	終了	2010 年 9 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	UC3637N	Die Sizes (mm):	2.44 X 2.24	
Assembly Site:	ALP - MMT	Package/Code/Pins:	PDIP/N/18	
Mount Compound:	Ablestik 84-1LMISR4	Mold Compound:	MP8000CH	
Bond Wire:	1.3 MIL Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test		Condition / Duration	Sample Size	
Manufacturability, Assembly		Per mfg. Site specification	per spec	
X-ray		Top side only	5	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 5 月 11 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	ULN2803AN	Die Sizes (mm):	3.04 X 1.74	
Assembly Site:	ALP - MMT	Package/Code/Pins:	PDIP/N/18	
Mount Compound:	Ablestik 84-1LMISR4	Mold Compound:	MP8000CH	
Bond Wire:	1.0 MIL Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Visual / Mechanical	-	Approved	Approved	Approved
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	11/0	11/0	11/0
Manufacturability, Assembly	Per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	Top side only	5/0	5/0	5/0
Solderability	-	22/0	22/0	22/0